IT/전기전자 이주형
02)368- 6190/jhlee2207@eugenefn.com

Contents

05
01 CES 2026 개요

09
02 주요 연설 요약

25
03 주요 참가 업체

31
04 기타 참가 업체

CES 2026 Key takeaways

① 바야흐로 Physical AI의 시대

- CES 2026 전시장 어느 곳을 가더라도 항상 로봇이 보일만큼, 많은 기업들이 휴머노이드를 통한 Physical AI의 구현을 정조준
- 휴머노이드 제조 역량과 세트 안정성은 빠르게 개선되고 있으나, 활용 방안에 대해서는 모두가 고민해보아야 한다고 생각
- 유니트리, 샤르파는 금번 CES에서 복싱, 탁구 경기, 종이접기 등 실제 생산성에 기여하는 모습보다는 퍼포먼스 위주의 데모를 진행
- 반면 현대자동차와 LG전자의 경우 각각 산업 현장 투입과 가사 노동 절감이라는 명확한 지향점을 제시
- 결국 실생활 투입 기반의 생산성 향상이라는 과제 달성이 Physical AI 시대의 경쟁력이 될 것이라고 생각

② Physical AI의 정수, Alpamayo

- CES 2026 엔비디아 키노트의 핵심은 자율주행 AI 플랫폼 Alpamayo
- 지난해 Cosmos 파운데이션 모델 공개에 이어 올해에는 Top Layer에 해당하는 Alpamayo를 공개하며 Full-stack 자율주행 플랫폼을 완성
- Alpamayo의 놀라운 주행 성능은 Cosmos가 만들어낸 합성 데이터에 기반을 두고 있으며, 향후 Alpamayo 플랫폼의 확장은 Cosmos의 합성 데이터의 수요를 증가시킬뿐만 아니라, 실주행 과정에서의 인과적 추론(Causal Reasoning)수요를 폭발적으로 증가시킬 것

③ Vera Rubin Achitecture

- 엔비디아는 차세대 Rubin 아키텍처 기반의 Vera Rubin NVL72 랙서버를 공개
- VR200 NVL72 랙서버는 GB300 NVL72 랙서버 대비 최대 60% 이상의 TDP를 요구하지만, 그보다 높은 컴퓨팅 파워 개선에 따라 시스템 수준의 에너지 효율을 2배 이상 개선. 차세대 아키텍처에서 특징은 Context 메모리 확장을 위한 DPU의 탑재가 가장 중요한데, 이는 랙서버당 최소 1,152TB에서 최대 2,700TB의 추가 NAND 수요를 발생시킬 수 있는 변화
- 생산 타임라인은 1분기 초 파일럿 생산, 2분기 말 양산 시작, 3분기 램프업으로 예상되며 관련 밸류체인 소재, 부품 업체들의 Q와 P 동시 상승 사이클을 기대

④ Vera Rubin Achitecture

- 엔비디아는 PC, 클라우드, AI 학습에 이어 다가올 Physical AI 시대에서의 인프라를 이미 구축해놓은 상황
- 휴머노이드의 확장, Alpamayo 플랫폼의 확장은 모두 컴퓨팅 수요의 폭발적인 증가에 기여할 것이며, 시스템 수준의 에너지 효율이 가장 우수한 엔비디아의 AI 시스템은 향후 지속적인 수요 확대를 경험할 것
- 엔비디아와 국내 엔비디아 밸류체인 업체들에 대한 선호 의견 유지

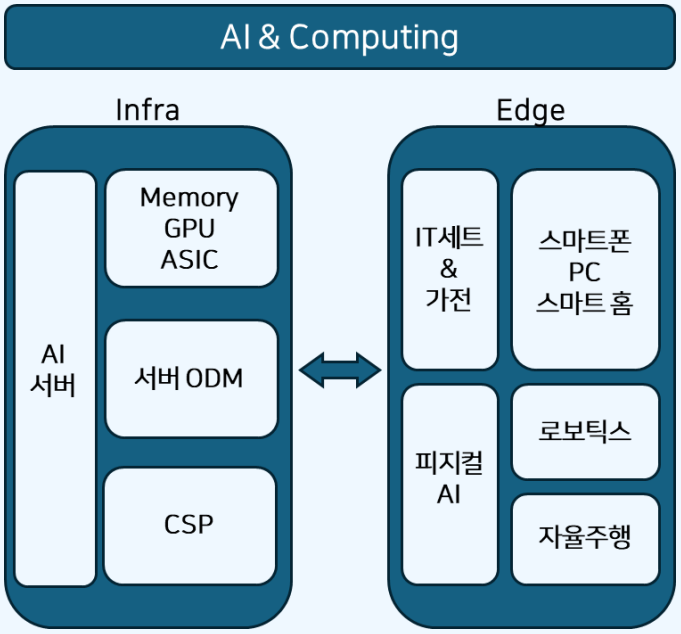
01

CES 2026 개요

한 눈에 보는 CES 2026

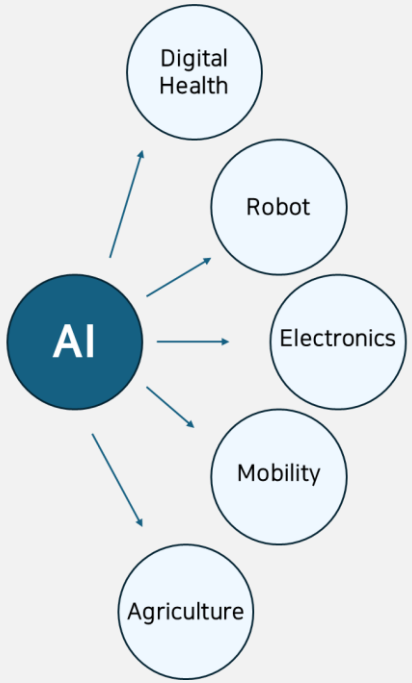
CES 2026
Innovators show up

핵심 테마	Physical AI, Spatial Computing, Mobility, Smart Home
참가기업 수	4,100여개
참관객 수	14.8만명 이상



CES 2025
Dive in

핵심 테마	AI, Robotics, XR, Digital Healthcare
참가기업 수	4,500여개
참관객 수	14.1만명 이상



CES 혁신상 수상 트렌드

	2026		2025		2024		2023	
카테고리	수상수	비중	수상수	비중	수상수	비중	수상수	비중
★Artificial Intelligence	46	10.8%	55	13.1%	36	7.5%	-	-
Digital Health	41	9.6%	49	11.7%	56	11.7%	86	16.1%
Smart Home	31	7.3%	20	4.8%	36	7.5%	49	9.2%
Vehicle Tech & Advanced Mobility	27	6.3%	20	4.8%	27	5.6%	53	9.9%
Home Appliances	26	6.1%	21	5.0%	27	5.6%	46	8.6%
Sustainability & Energy Transition	25	5.9%	35	8.3%	38	7.9%	35	6.6%
Computer Hardware & Components	21	4.9%	24	5.7%	17	3.5%	13	2.4%
Products in Support of Human Security for All	19	4.5%	17	4.0%	18	3.8%	8	1.5%
Enterprise Tech	17	4.0%	-	-	-	-	-	-
Computer Peripherals & Accessories	17	4.0%	12	2.9%	21	4.4%	39	7.3%
★Robotics	17	4.0%	16	3.8%	14	2.9%	18	3.4%
Embedded Technologies	15	3.5%	5	1.2%	24	5.0%	30	5.6%
Construction & Industrial Tech	13	3.1%	-	-	-	-	-	-
Accessibility & Longevity	12	2.8%	17	4.0%	24	5.0%	14	2.6%
Smart Communities	12	2.8%	20	4.8%	16	3.3%	22	4.1%
XR & Spatial Computing	12	2.8%	20	4.8%	8	1.7%	-	-
Content & Entertainment	10	2.3%	10	2.4%	13	2.7%	-	-
Digital Imaging & Photography	10	2.3%	17	4.0%	9	1.9%	12	2.2%
Headphones & Personal Audio	9	2.1%	5	1.2%	14	2.9%	5	0.9%
Gaming & eSports	8	1.9%	11	2.6%	13	2.7%	22	4.1%
Cyber Securities & Personal Privacy	6	1.4%	3	0.7%	7	1.5%	7	1.3%
Pet & Animal Tech	6	1.4%	7	1.7%	-	-	-	-
Fitness & Sports	6	1.4%	4	1.0%	8	1.7%	10	1.9%
Drones & Advanced Air Mobility	5	1.2%	5	1.2%	5	1.0%	3	0.6%
Food & Ag Tech	5	1.2%	-	-	7	1.5%	7	1.3%
In-Vehicle Entertainment	4	0.9%	4	1.0%	6	1.3%	16	3.0%
Financial Technologies	3	0.7%	4	1.0%	1	0.2%	-	-
Video Displays	3	0.7%	4	1.0%	5	1.0%	15	2.8%

편집상의 공백페이지입니다

02

주요 연설 요약

CES 2026 Key Message 비교

엔비디아

AI를 중심으로 한 새로운 컴퓨팅 플랫폼 전환

- 컴퓨팅 산업은 메인프레임 → PC → 인터넷 → 모바일 → 클라우드로 플랫폼 전환을 반복해 왔음
- AI시대는 기존 전환과 달리, 앱이 AI 위에 구축되는 이중 전환으로 정의됨
- SW 개발·실행 방식이 CPU ·사전 컴파일 중심에서 GPU ·트레이닝 ·실시간 생성으로 전환
- Scaling Law 지속으로 모델 크기, 토큰 수, 컴퓨팅 수요가 급격히 증가
- 이에 대응하는 인프라로 Vera Rubin 아키텍처, Bluefield-4 DPU, AI Factory의 개념을 제시

AMD

AI 확산의 전제 조건은 컴퓨트 인프라의 확장

- AI는 지난 50년간 가장 중요한 기술로, 모든 산업과 일상에 영향을 미치는 중
- AI의 기반은 컴퓨트이며, 글로벌 컴퓨트 인프라는 2022년 1ZF에서 2025년 100ZF로 100배 증가
- AI를 어디에서나 구현하기 위해서는 향후 5년 내 100배의 컴퓨트 확장이 필요
- Helios Rack Scale Server를 통해 Yotta Scale AI 시대를 위한 차세대 컴퓨트 인프라를 제시

Lenovo

하이브리드 AI를 실제 환경에 구현

- AI는 개인과 기업 모두에게 더욱 개인적이고, 실질적인 가치를 제공해야함
- 개인 AI, 기업 AI, 공공 AI가 결합된 하이브리드 AI 비전을 제시
- NVIDIA와 함께 Lenovo AI Cloud Gigafactory를 공식 런칭
- Vera Rubin 기반 대규모 AI 인프라와 Lenovo Neptune 액체 냉각을 결합
- 개인 AI Qira(KIRA), 엔터프라이즈 AI 인퍼런싱 서버 등 실행 계층을 중심으로 포트폴리오 확장

엔비디아 NVIDIA

Jenson Huang

① 컴퓨팅 산업에서의 플랫폼 전환

- 컴퓨팅 산업에서는 10~15년 주기로 플랫폼 전환이 발생
- 메인프레임 → PC → 인터넷 → 모바일 → 클라우드로의 전환
- 플랫폼 전환은 새로운 애플리케이션의 탄생을 수반
- AI 시대는 단순한 전환이 아닌, 애플리케이션이 AI 위에 구축되는 **이중전환**
- **① 애플리케이션이 AI 위에 구축**되며, **② 소프트웨어 개발 방식의 근본적인 변화**를 수반
  : AI 초기, 시장은 AI 자체를 애플리케이션으로 이해했으나, **AI는 새로운 앱을 만드는 플랫폼으로 진화**했으며, ChatGPT와 같은 AI가 기반이 되어 다양한 도메인 앱을 가능하게 함. **소프트웨어 개발 ·실행의 방식이 프로그래밍 & CPU & 사전 컴파일에서 트레이닝 & GPU & 실시간 생성으로 전환**
- 기존 컴퓨팅 인프라가 AI로 전환되며 VC 투자와 R&D 예산이 컨벤셔널 컴퓨팅에서 AI로 이동하는 중이며, 이는 산업 전체의 재편을 의미

컴퓨팅 산업에서의 플랫폼 시프트

자료: ChatGPT, 유진투자증권

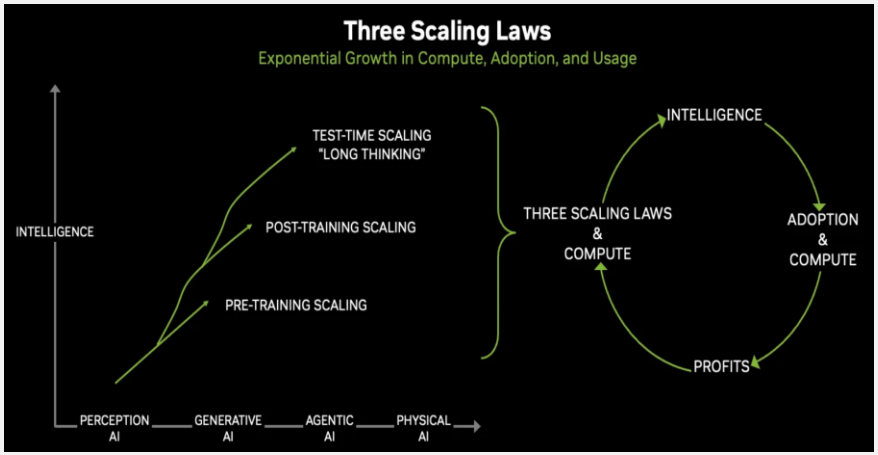
② Scaling Law의 지속

- 스케일링 법칙의 지속으로 AI 모델의 크기와 컴퓨팅 용량이 지속 확대
- BERT → ChatGPT → o1 모델까지의 진화를 통해 단계별 컴퓨팅 용량이 급증
- 특히, **o1 모델은 기존 학습에는 없던 Test-time scaling(생각 & 추론)개념을 도입**, 실시간 추론으로 AI가 더 똑똑해지는 결과를 가져왔으며 **이는 Agentic AI의 기반**이 됨
- 특히 젠슨황은 Cursor를 SW 개발 혁명의 사례로 제시하며, AI가 단순 응답에서 행동하는 에이전트로 진화함을 언급

③ Agentic AI & 미래 애플리케이션 아키텍처

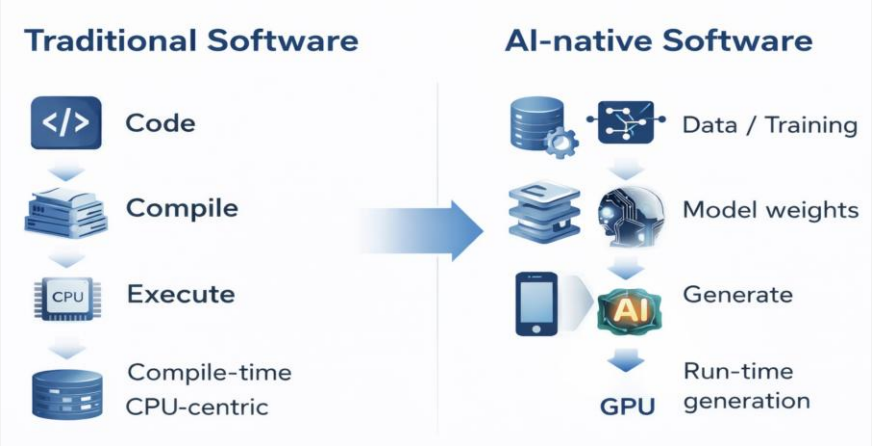
- ChatGPT의 초기 환각(잘못된 정보 생성)은 지식의 한계로 인해 발생
- RAG(검색 기반 Grounding)과 적절한 Tool 사용을 통해 해결할 수 있다고 언급
- **Reasoning(추론)과 Planning(계획)으로 AI가 문제를 연구하고 분해하며, 이전에 훈련되지 않았던 작업을 수행하는 것이 Agentic AI의 핵심**이며, 이는 **AI가 인간처럼 새로운 상황에 대응하는 것을 의미**
- 또한, **최적의 모델을 상황에 맞게 호출하는 Perplexity의 멀티모델 라우팅**이 미래 애플리케이션의 기본 프레임워크가 될 것이라고 강조
- 미래 애플리케이션은 AI 위에 구축되는 도메인 앱의 모습으로, 사용자의 의도에 따라 모델을 라우팅하는 Agentic 구조를 가질 것. 이는 앱 개발 속도의 향상과 더불어 이전에는 불가능했던 작업을 가능하게 할 것이라고 언급

컴퓨팅 성능의 세 가지 확장 법칙과 지수적 성장



자료: NVDA, 유진투자증권

소프트웨어 개발 방식의 변화



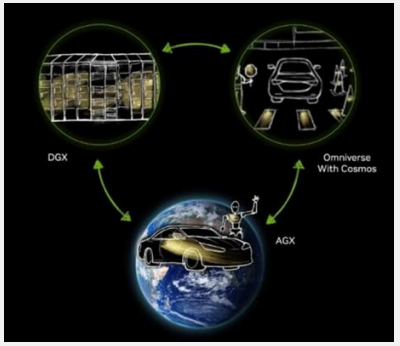
자료: ChatGPT, 유진투자증권

④ NVIDIA의 오픈 모델

Nemotron 3
(Agentic AI)

- Test-time Scaling을 길게 하거나, 빠르게 답변하는 하이브리드 멀티모달 추론 모델
- Nemo 라이브러리와 함께 오픈소스화, 산업 표준으로 자리매김

Cosmos
(Physical AI)



- 세계의 작동 방식을 이해하는 오픈 월드 모델로, 언어와 물리 시뮬레이션을 결합
- AV/로봇 학습에 사용되며, 합성 데이터 생성으로 데이터 부족 현상을 해결
- Physical AI의 핵심 기반

GR00T
(Robotics)

- 휴머노이드 로봇의 관절, 이동, 로코모션을 위한 모델로, Omniverse에서 학습됨
- Physical AI의 로봇 산업 내 적용 예시

Alpamayo
(Autonomous Vehicles)

- 세계 최초의 "생각하고 추론하는" 자율주행 AI 모델
- 카메라 입력부터 조향 및 가속까지 전체 파이프라인을 End-to-End로 학습
- Mercedes와 협력해 2026년 도로 주행 예정

⑤ Physical AI란

- 젠슨황은 **"Physical AI의 ChatGPT 모멘트가 임박했다"**고 언급하며 전체 발표에서 가장 긴 시간을 Physical AI, Cosmos, Alpamayo 설명에 할애
- **Physical AI란, AI가 물리적 세계와 직접 상호작용하는 것**을 의미하며, 로봇, 자율주행, 공장 자동화 등에서 Physical AI 구현을 위해서는 객체 영속성, 인과관계, 마찰, 중력, 관성 등과 같은 **물리적 상식을 이해하는 것이 필요**
- **AI Physics는 물리법칙을 이해하고 시뮬레이션 하는 AI**로써, 엔비디아의 Cosmos가 이에 해당
- 다만, 물리적 세계는 long-tail edge case가 무한에 가까울 만큼 다양하고 예측 불가능하며 데이터 수집의 속도가 느림
- 엔비디아는 이에 대한 해결책으로 **합성 데이터 + 시뮬레이션**을 제시

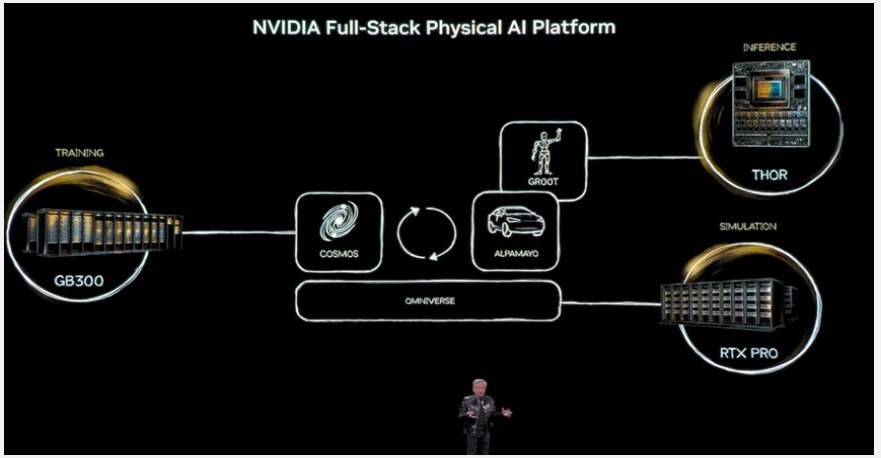
⑥ Cosmos: World Foundation Model

- Cosmos = 인터넷 스케일 비디오 + 실제 주행·로봇 데이터 + 3D 시뮬레이션으로 사전 컴파일 된 World Foundation Model
- 언어, 이미지, 3D, 액션, 비디오를 하나의 통합 표현(unified representation)으로 이해
- 주요 기능

: 1) 물리적으로 일관된 비디오 생성, 2) 객체의 움직임 예측, 3) 엣지케이스 시뮬레이션, 4) 가능한 미래를 분석 및 분해

- **Cosmos는 현실 세계의 비싸고 느린 데이터 수집의 한계를 3D 시뮬레이터 출력 및 대량의 고품질 비디오 생성을 통해 극복**

엔비디아의 풀스택 Physical AI 플랫폼



자료: NVDA, 유진투자증권

Cosmos 모델 구조 도식화

자료: NVDA, 유진투자증권

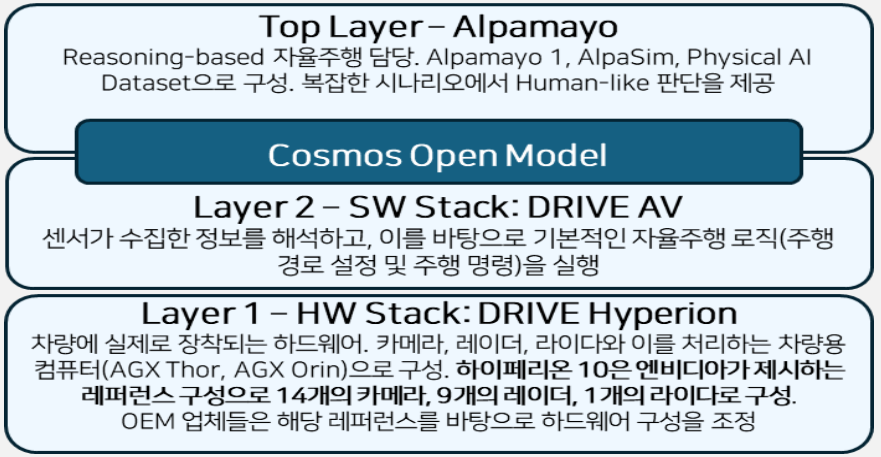
⑦ Alpamayo

- 세계 최초의 **"생각하고 추론하는(thinking, reasoning)" 자율주행 AI 플랫폼**; 오픈 모델 + 시뮬레이션 툴 + 데이터셋으로 구성
- 카메라 입력 → 추론 → 조향, 브레이크, 가속에 이르는 **End to End 파이프라인**을 제공
- Alpamayo의 데이터셋은 Cosmos가 생성한 대량의 장거리, 엣지케이스 합성 데이터와 실제 사람의 운전 영상으로 구성
- Alpamayo는 **1) 취할 행동, 2) 그 행동을 선택한 이유, 3) 예상 궤적으로 구성된 인과적 추론(Causal Reasoning)레이어를 도입**
- 따라서 조향, 브레이크, 가속 등의 행동 전에 **"왜 이 행동을 하는지 " 에 대한 Chain-of-thought reasoning 설명이 가능**
- 엔비디아는 추론 중심의 Alpamayo에 대해 복잡한 상황에서 강력한 성능을 보이지만, 완벽히 안전하다고 100% 확신할 수는 없다고 언급
- 신뢰성 강화를 위해 추론 중심의 Alpamayo와 규칙과 지도를 기반으로 한 고전 AV 스택을 동시에 활용
- **1분기 내 미국 도로 주행을 시작으로 2분기 유럽, 3~4분기 아시아까지 확대할 계획**이며, **"향후 10년 안에 거의 모든 승용·상용차가 고도/완전 자율주행이 가능할 것 "** 이라고 전망
- 엔비디아의 Alpamayo는 메르세데스-벤츠 CLA 차량 내 최초 탑재

Alpamayo 구조 도식화

자료: NVDA, 유진투자증권

엔비디아의 자율주행 플랫폼



자료: NVDA, 유진투자증권

⑧ Vera-Rubin Architecture

- **AI 모델의 파라미터 수는 매년 10배씩 증가**
- Test-time scaling 단계에서 모델이 생각하는 시간이 길어질수록 종종 더 나은 답변을 생성. 이에 따라 **Test-time scaling 단계에서 생성되는 토큰 수는 매년 5배씩 증가**
- **AI가 다음 프론티어에 도달할 때마다, 이전 세대 대비 AI 토큰 생성 비용이 10배씩 하락**
- 얼마나 빨리, 얼마나 큰 모델을 훈련할 수 있는지가 다음 프론티어에 먼저 도달하는 방법
- 전력 및 냉각 성능의 제한 내에서 데이터센터의 성능을 확장해야하는 끊임없는 수요가 발생
- Rubin의 토큰 생성 비용은 Blackwell 대비 1/10 수준
- VR200 NVL72 랙서버는 GB300 NVL72 랙서버 대비 3.5배 높은 학습 성능과 5배 높은 추론 성능을 제공. Vera Rubin은 최대 230kW의 랙 TDP를 요구하며, 이는 Grace Blackwell의 140kW 대비 유의미하게 높은 수치이나, 그보다 높은 컴퓨팅 파워 개선에 따라 **시스템 수준의 에너지 효율 2배 개선**
- 랙서버 TDP가 200kW를 상회함에 따라, Rubin Ultra 기반의 차세대 랙서버부터 800V HVDC 카이버 랙 디자인이 적용될 예정
- Vera Rubin의 생산 타임라인은 **1분기 초 파일럿 생산, 2분기 말 양산 시작으로 파악됨**

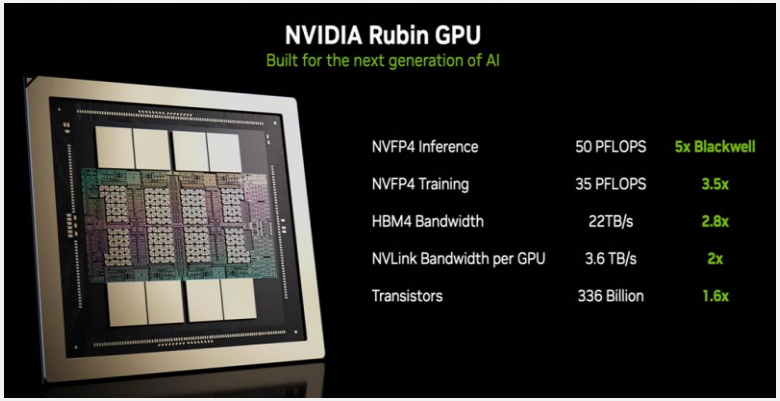
AI 컴퓨팅 파워에 대한 끊임없는 수요

자료: NVDA, 유진투자증권

Vera Rubin NVL 72 개요

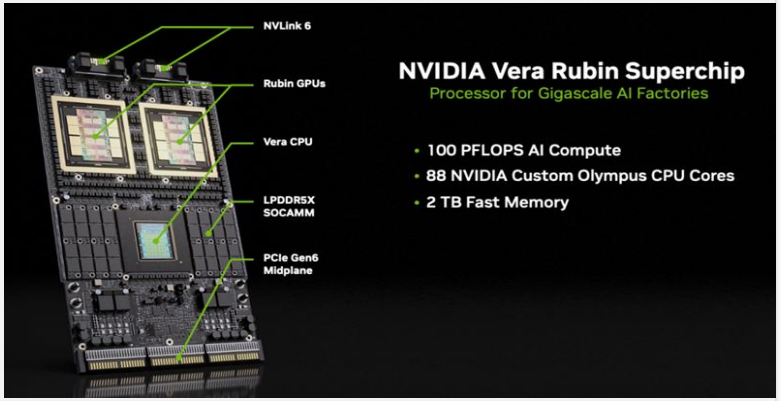
자료: NVDA, 유진투자증권

Rubin GPU



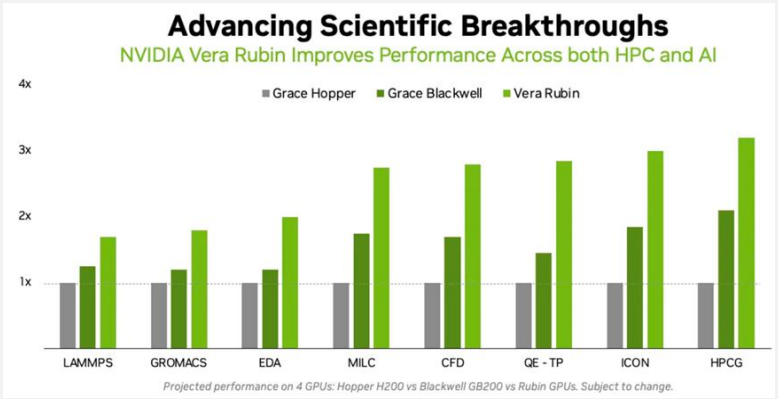
자료: NVDA, 유진투자증권

Vera Rubin SuperChip



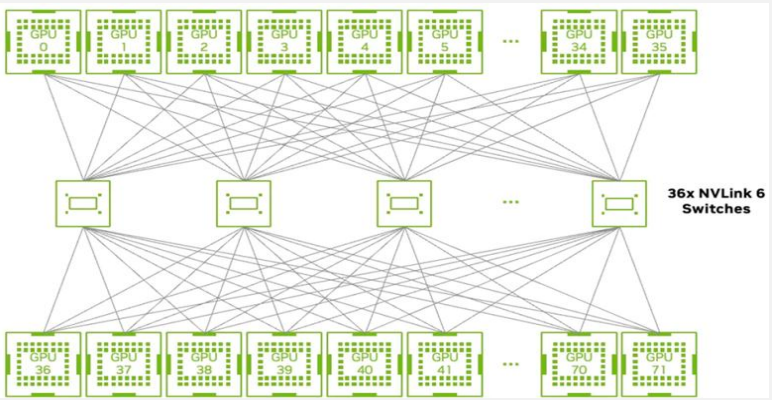
자료: NVDA, 유진투자증권

NVIDIA GPU 시뮬레이션 성능



자료: NVDA, 유진투자증권

Vera Rubin NVL 72 NVLink 전체 연결 토폴로지



자료: NVDA, 유진투자증권

⑨ Vera-Rubin; Bluefield-4 DPU 탑재

- Vera Rubin 아키텍처에서 주요 변경점은 1) Context 메모리 확장을 위한 DPU의 탑재, 2) Cable-less & Tube-less & Fan-less 설계를 통한 조립 시간 단축으로 요약할 수 있음

1) Bluefield-4 DPU

- GPU는 모델 전체를 읽고 하나의 토큰을 생성, 이를 KV캐시에 저장(추론 시 중간 단계에서 계산된 Key와 Value를 Context 메모리에 저장하고 재사용하는 메커니즘. 이를 통해 **불필요한 계산을 피하고 작업 속도를 향상**시키는 것). 다만, 사용자 쿼리가 발생할 때마다 KV캐시에 저장되는 토큰의 양이 증가
- 이에 따라 **Key와 Value가 저장되는 Context 메모리의 확장이 필요**해짐. 엔비디아는 전체 Dynamo KV캐시 Context 메모리 관리를 위해 **Bluefield-4 DPU를 컴퓨트 트레이마다 한 개씩 탑재**
- DPU는 Context 메모리 확장과 더불어 스토리지와 보안의 기능을 전담하며 컴퓨트 트레이가 AI에 전적으로 집중할 수 있는 환경을 조성. Bluefield-4 기반 Vera Rubin 플랫폼 도입을 통해 초당 토큰 처리량과 전력 효율성을 기존 대비 최대 5배까지 향상
- **Bluefield-4 DPU는 최대 150TB의 스토리지를 탑재할 수 있으며, 각 GPU에 추가 16TB의 스토리지를 할당**
- VR200 NVL72 기준으로 계산했을 때, **랙서버당 최소 1,152TB, 최대 2,700TB의 NAND 수요가 추가로 발생**할 수 있을 것. **2027년 연간 VR200 NVL72 랙서버 출하량을 7~8만대로 가정 시, 현재 NAND TAM인 14.7억 TB 대비 최소 5.5%, 최대 14.7%의 NAND 수요 증가가 예상됨**

Bluefield-4 DPU

자료: NVDA, 유진투자증권

DPU 탑재에 따른 NAND 추가 수요 예상

2027년 연간 VR200 NVL72 출하량(대)		70,000	80,000
랙당 NAND 탑재량(TB)		NAND 수요 증분(억 TB, TAM 대비 %)	
DPU 기준(유닛당 150TB)	2,700	1.9(12.9%)	2.2(14.7%)
GPU 기준(유닛당 16TB)	1,152	0.8(5.5%)	0.9(6.3%)
NAND 전체 시장 규모(억 TB)		14.7	

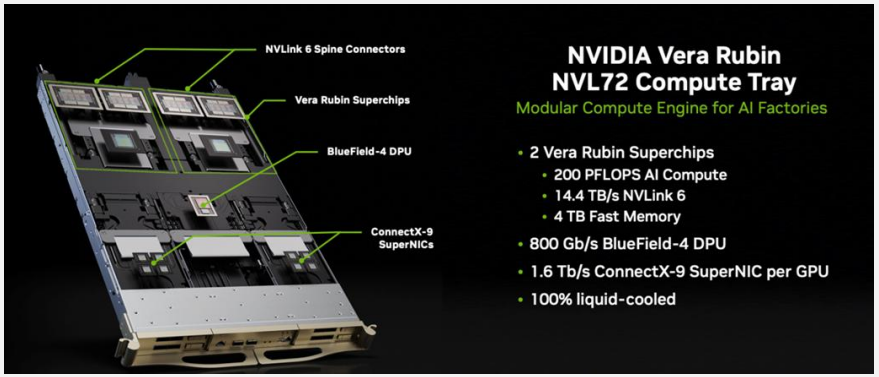
자료: 유진투자증권

⑨ Vera-Rubin; 모듈식 어셈블리

2) Cableless, Tubeless, Fanless 설계

- 기존의 엔비디아 MGX 섀시는 복잡한 구조로 인해 컴퓨트 트레이의 조립과 테스트에 2시간의 시간이 소요
- 반면, Vera Rubin 컴퓨트 트레이는 두 개의 슈퍼칩, 전원 공급 장치, 냉각 장치, 네트워킹 칩 등을 **케이블이 없는 모듈식 어셈블리로 통합하고 기존 케이블의 역할을 미드플레인(Midplane)PCB 도입으로 대체.** 이때 미드플레인 PCB는 44층의 높이를 가질 것으로 예상되며, M9 등급의 CCL이 사용될 것으로 예상됨
- 케이블, 튜브, 팬이 없는 컴퓨트 트레이는 기존 케이블 방식 트레이 설계에서 발생하던 조립 및 유지보수의 불편함을 해소해주며, 설계의 간소화를 통해 **트레이 조립 시간을 2시간에서 5분으로 약 96% 단축**. 또한, **현장 유지보수 소요시간을 크게 단축하여 TCO 절감에 기여**

Vera Rubin NVL 72 컴퓨트 트레이



자료: NVDA, 유진투자증권

Vera Rubin NVL 72 컴퓨트 트레이의 모듈식 어셈블리

자료: NVDA, 유진투자증권

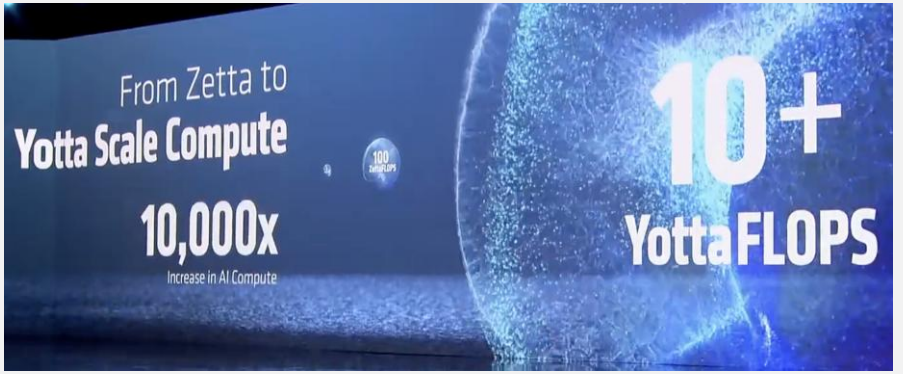
AMD AMD

Lisa Su

① 글로벌 컴퓨트 인프라의 폭발적 확장

- AI 확산에 따라 글로벌 컴퓨트 인프라는 2022년 약 1ZF(제타플롭스)에서 2025년 100ZF로 100배 증가
- 그러나 AI 수요 충족을 위해서는 현재의 증가 속도는 현저히 부족
- 'AI is Everywhere' 구현을 위해서는 향후 5년 내 컴퓨트 용량을 다시 100배 확대해 10YF(요타플롭스) 이상으로 키워야 함을 언급
- 이는 2022년 대비 10,000배에 해당하는 전례 없는 확장 속도
- AMD는 이 전환의 핵심 컴퓨트 인프라 공급자로 자리매김하겠다는 전략을 명확히 함

글로벌 컴퓨트 수요의 확장 속도



자료: AMD, 유진투자증권

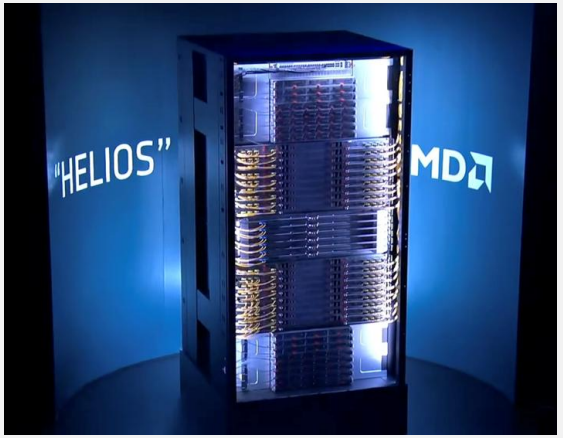
② AI is Everywhere, AI is for Everyone

- AI는 특정 기업이나 산업에 국한되지 않고 모든 사람과 산업으로 확산될 것
- AI는 생산성 향상, 의사결정 고도화, 개인 및 조직 역량 증폭의 핵심 기술로 정의됨
- AMD의 목표는 최첨단 AI 역량이 소수에 집중되지 않도록 하는 것
- 이를 위해 클라우드·PC ·엣지 전반에 AI 컴퓨트를 내재화하는 전략을 제시

③ Yotta Scale AI 인프라, Helios

- Helios는 Yotta Scale AI 시대를 겨냥한 AMD의 랙 스케일 플랫폼
- 단일 서버 성능 향상이 아닌, 랙 단위에서 하나의 거대한 컴퓨트 유닛처럼 동작하도록 설계된 것이 핵심
- Instinct MI455X 가속기, EPYTC Zen 6 CPU, Pensando DPU/네트워킹을 컴퓨트 트레이 단위로 통합
- UALink 기반 스케일업 구조를 통해 랙 내 72개 GPU를 연결
- 대규모 트레이닝과 분산 추론을 동시에 수행하는 AI 팩토리 표준을 목표로 함

AMD의 Helios Rack



자료: AMD, 유진투자증권

AMD Instinct MI355X, MI455X, NVDA Rubin 스펙 비교

구분	MI355X	MI455X	R200
아키텍처	CDNA 4.0	CDNA 5.0	Rubin
메모리	HBM3E	HBM4	HBM4
메모리 용량(GB)	288	432	288
메모리 대역폭(TB/s)	8	19.6	22
랙/시스템 구성	단품	Helios	VR NVL72
FR4 계열 성능 지표	10.066 PFLOPS (MXFP4)	40.278 PFLOPS (FP4)	50 PFLOPS (NVFP4 Inference)

자료: AMD, NVDA, 유진투자증권

Lenovo Lenovo

Yuanqing Yang

① Lenovo AI Cloud Gigafactory

- NVIDIA와 협력하여 Lenovo AI Cloud Gigafactory를 공식 런칭
- GB300, Vera Rubin 플랫폼 기반으로 수십만 GPU 규모의 초대형 AI 팩토리 구축을 지원하며, CSP로 하여금 TTFT(Time to First Token)를 획기적으로 단축하고 조단위 파라미터 규모의 LLM을 운용할 수 있도록 설계
- Lenovo는 Top500 슈퍼컴퓨터의 약 1/3을 구축한 시스템 통합 경험을 차별화 요소로 제시
- 이는 제조-설치-운영 및 서비스까지 턴키 제공이 가능한 AI 인프라 사업 기회로 예상됨

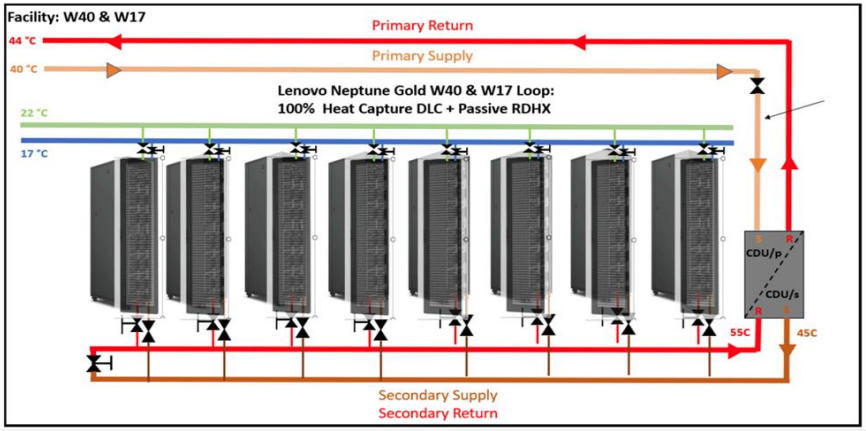
② Neptune 액체 냉각 기술 결합

- Lenovo AI Cloud Gigafactory에는 Lenovo의 Neptune 액체 냉각 기술이 핵심 요소로 결합됨
- Neptune은 CPU·GPU에 직접 냉각수를 순환시키는 Direct-to-Chip Liquid Cooling 기술
- Neptune 냉각 방식의 범주는 Warm Water, Core, Air, Rear-door 열교환(RDHX) 등으로 구성되어 있으며, Gold, Silver, Bronze의 티어별 구성을 제공
- Lenovo Neptune Gold 설계 적용 시, 최대 100%의 열포집 효율 구현이 가능

Lenovo AI Cloud Gigafactory 발표 장면

자료: Lenovo, 유진투자증권

Lenovo Neptune Gold 구조

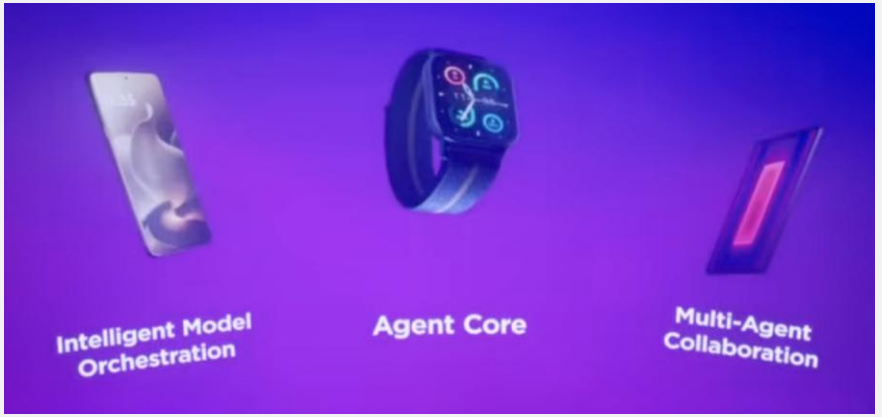


자료: Lenovo, 유진투자증권

③ Lenovo의 하이브리드 AI

- Lenovo는 하이브리드 AI를 개인 AI·기업 AI·공공 AI의 결합 구조로 정의
- 이를 구현하는 핵심 기술로 Intelligent Model Orchestration, Agent Core, Multi-Agent Collaboration을 제시
- AI는 단일 모델이 아니라 목적과 맥락에 따라 최적의 모델과 에이전트를 호출하는 구조
- 에이전트는 의도를 이해하고 작업을 분해하며 선제적으로 행동하도록 설계됨
- 에이전트 네이티브 애플리케이션 시대의 기술적 기반으로 제시

Lenovo의 하이브리드 AI



자료: Lenovo, 유진투자증권

④ 개인 AI ‘Lenovo Qira’ 런칭

- 개인 AI 슈퍼 에이전트인 Lenovo Qira를 공식 런칭
- 스마트폰, PC, 태블릿, 웨어러블 기기 전반을 아우르며 사용자의 컨텍스트를 통합 관리
- 단기 ·장기 기억을 유지하고 음성과 텍스트를 통한 입력을 모두 지원하며 단순 질의응답을 넘어 실행과 모델 오케스트레이션까지 담당하는 구조

Lenovo의 개인 AI 슈퍼 에이전트, Qira

자료: Lenovo, 유진투자증권

⑤ Motorola Razr Fold & Signature

- Motorola의 프리미엄 폴더블 신제품 Razr Fold와 Signature 공개
- Razr Fold는 8.1인치 대형 폴더블 디스플레이와 AI 기반 스케치-투-이미지 기능을 제공
- Signature는 초박형 디자인과 고성능 온디바이스 AI를 강조한 플래그십 모델
- 두 제품 모두 개인 AI 슈퍼 에이전트 Qira와의 긴밀한 연동을 전제로 설계
- 이는 스마트폰을 개인 AI 경험의 핵심 단말로 재정의하려는 Lenovo의 전략으로 해석됨

Motorola Razr Fold

자료: Motorola, 유진투자증권

Motorola Razr Signature

자료: Motorola, 유진투자증권

03

주요 참가 업체

삼성전자

Your Companion to AI Living

- 삼성전자는 지난 CES까지는 LVCC 메인홀에 부스를 구성했으나, 금번 CES 2026에서는 Wynn Las Vegas 호텔의 단독 공간에서 'The First Look 2026' 부스를 운영
- 삼성전자의 CES 부스 구성은 TV·가전 ·모바일 ·반도체가 각각 독립적으로 존재하는 것이 아니라, AI 플랫폼을 중심으로 유기적으로 연결되는 흐름을 체험형 동선으로 자연스럽게 설계
- 핵심 제품은 Micro RGB 기반 초대형 TV로, 초미세 RGB LED 백라이트를 적용한 130인치 모델을 전면에 배치. 해당 제품은 CES 2026 최고 혁신상을 수상
- 가전 영역에서는 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra를 중심으로 AI 인식 ·판단 ·주행 기술을 강조
- 액체, 케이블 등의 장애물 인식과 최대 60mm의 문턱을 주행하는 등 실사용 중심의 기능을 시연
- 금번 CES에서 삼성전자는 '로봇형 가전'보다는 '가전의 AI 내재화'라는 방향성을 제시

Wynn Las Vegas 삼성전자 부스

자료: 삼성전자, 유진투자증권

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

자료: 삼성전자, 유진투자증권

LG전자

Innovation in tune with you

- LG전자는 LVCC Central Hall에서 전시를 진행했으며, AI가 사용자의 환경을 인식하고 상황에 맞게 기기를 제어하는 구조를 공간 단위로 구현
- 금번 CES에서 LG전자 부스는 개별 제품 전시보다는 거실·주방·모빌리티 공간 등 실제 생활 환경을 중심으로 AI 동작 흐름을 보여주는 방식으로 구성
- 핵심 제품으로는 투명 OLED와 무선 AV 전송 기술을 결합한 LG SIGNATURE OLED T를 전면에 배치. 해당 제품은 CES 2026 최고 혁신상을 수상
- 로봇 영역에서는 가사 보조에 특화된 LG CLOiD를 전시. 세탁물 정리, 간단한 음식물 조리, 반복 작업 수행 등 실생활 활용 시나리오를 중심으로 데모 진행. CLOiD는 LG의 핵심 모터 기술과 올인원 드라이브 기술을 통해 작지만 고토크의 성능을 구현했으며, 3D 방열 기술을 통해 장시간 이용에도 안정적 구동이 가능
- 금번 CES에서 LG전자는 휴머노이드 로봇보다는 AI가 가전과 로봇에 자연스럽게 적용되는 생활 밀착형 AI 전략을 강조

무선 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 evo W6’로 구성된 메인 부스

자료: LG전자, 유진투자증권

LG CLOiD

자료: LG전자, 유진투자증권

현대자동차그룹

Partnering Human Progress

- 금번 전시에서 현대자동차그룹은 전기차·자율주행보다는 로보틱스를 차세대 성장의 축으로 전면에 배치
- 핵심 전시물은 Robotics LAB의 이동형 로봇 플랫폼 MobED로, 해당 제품은 CES 2026 로보틱스 부문 최고 혁신상을 수상
- MobED는 평지·경사·계단 주행이 가능한 다관절 이동 플랫폼으로, 산업·물류·서비스 환경 적용 가능성을 중심으로 소개
- 또한 Boston Dynamics의 Atlas를 함께 전시하며 고난도 작업 수행 및 AI 기반 동작 학습 역량을 강조
- 현대차그룹은 2028년까지 연 3만대 수준의 로봇 생산 역량 확보라는 목표를 제시하며 로보틱스 상용화 단계 진입의 의지를 명확히 드러냄

Boston Dynamics의 Atlas

자료: 현대자동차, 유진투자증권

Robotics LAB의 MobED

자료: 현대자동차, 유진투자증권

두산그룹

Comprehensive Energy Solutions for the AI Era

- 두산그룹은 LVCC West Hall에서 두산에너빌리티와 HyAxiom을 중심으로 가스터빈, SMR, 연료전지 솔루션을 전시
- AI데이터센터 및 대규모 컴퓨팅 인프라 확산에 따른 전력 수요 증가를 전제로, 기저부하·무탄소·고효율 전원 포트폴리오를 강조
- 로봇 영역에서는 두산로보틱스가 Scan & Go와 AI Depalletizer 솔루션을 전시
- Scan & Go는 3D 비전과 포인트클라우드 기반으로 작업 경로를 자동 생성하는 구조로, CES 2026 혁신상을 복수 수상
- 엔비디아의 블랙웰 아키텍처 내 컴퓨트 트레이에 독점적으로 공급하고 있는 전자BG의 CCL 역시 참가자들의 많은 관심을 받음
- 두산은 금번 CES에서 AI 시대의 핵심 인프라인 '전력'과 '자동화 로봇'을 동시에 제시하며 인프라 중심의 기업 이미지를 부각시킴

두산 전자BG의 CCL

자료: 두산, 유진투자증권

두산의 Scan & Go

자료: 두산로보틱스, 유진투자증권

Hisense

Innovating a Brighter Life

- 금번 전시에서 하이센스는 Central Hall에서 MicroLED, MiniLED, Laser TV 등 대형 디스플레이 중심의 전시를 구성
- 특히 RGBY 구조를 적용한 163MX MicroLED를 전면에 배치했으며, 해당 제품은 CES 2026 디스플레이 부문 최고 혁신상을 수상
- 스마트홈 생태계에 대한 전시 및 휴머노이드 서비스 로봇 Harley의 데모도 진행되었으나, 전반적인 부스 구성은 디스플레이에 초점

Hisense의 휴머노이드 'Harley'

자료: Hisense, 유진투자증권

TCL

Inspire Greatness

- CES 2026의 메인 스폰서인 TCL은 LVCC Central Hall의 가장 큰 전시 공간을 차지, 3,368m^2 규모의 단일 부스를 운영
- TCL은 AiMe Land(에이미 랜드)라는 별도의 공간을 구성하여 디스플레이 기술과 AI 기반 스마트 리빙을 동시에 전시
- 또한 초대형 TV 및 고휘도 MiniLED 디스플레이를 전면에 배치, 디스플레이 기술 경쟁력을 강조
- 로봇 영역에서는 AI 컴패니언 로봇인 'AiMe'를 부스 중앙에 배치. AiMe는 이동형 플랫폼과 감정 표현 중심의 디자인을 통해 동반자형 AI 디바이스로 포지셔닝

TCL의 AI 컴패니언 로봇 'AiMe'

자료: TCL, 유진투자증권

04
기타 참가 업체

DEEPX

- DEEPX는 초저전력 엣지 AI 반도체를 핵심으로 전시를 진행. 대규모 체험형 전시보다는 산업용·로봇·비전 시스템에 실제 적용되고 있는 엣지 AI SoC 데모 중심으로 구성
- 주요 전시 제품은 비전 위주의 DX-M1칩과 서버용 DX-H1 계열 NPU로, 수 와트급 전력 소모로 수십 TOPS급 추론 성능을 구현하는 점을 강조
- DEEPX는 클라우드 의존도를 낮추고, 로봇·스마트팩토리·의료기기 등에서 온디바이스 추론을 가능하게 하는 것이 핵심 전략임을 강조
- DX-M1칩의 후속작인 DX-M2는 엣지 디바이스 내 20B~100B 파라미터 규모의 LLM에 대한 추론을 수행하는 칩으로 계획 중이며, 연말 출시를 목표로 함. 해당 칩은 삼성 파운드리의 2nm 노드로 생산될 예정

BH EVS

- BH EVS의 캐시카우인 차량용 무선충전모듈의 경우 선행 개발이 가능한 기술력과 가격 경쟁력이라는 장점에 더해, 자동차라는 높은 신뢰성이 요구되는 애플리케이션에서의 탈중국 수혜를 누리는 중
- 모바일 애플리케이션의 스펙 고도화, 차량 내 디스플레이 탑재 확대 트렌드에 따라 싱글에서 듀얼로 충전 모듈수가 확대되고 있으며, 별도의 HDMI 케이블 없이 차량 내 디스플레이에 사용자 기기의 미러링이 가능한 모듈을 구현
- 로보틱스의 경우 현대자동차의 MobED향 번들 충전기를 3월부터 양산 및 공급할 계획이며, 향후 PIuD향 충전기 역시 납품 예정
- BH EVS는 전장 및 전력 관련 노하우를 바탕으로 자율주행 차량용 유·무선 충전모듈을 개발중이며, 이 중 무선 충전모듈의 경우 지속적인 시험 탑재를 통해 상업성을 확인하는 중

DEEPX의 엣지 AI 시스템 제품 라인업

자료: DEEPX, 유진투자증권

BH EVS가 공급하는 MobED 충전기

자료: BH EVS, 유진투자증권

UNITREE

- 유니트리 로보틱스는 G1, H2, R1을 포함한 자사 휴머노이드 로봇 전체 라인업을 공개
- 금번 CES에서 유니트리는 North Hall에서 매우 소규모의 부스를 운영하였으며 그 규모는 국내 상장사인 마음AI보다 작았음
- 그럼에도 불구하고 G1 모델끼리의 복싱 경기, G1 모델과 참가자의 복싱 경기 등 눈길을 끌만한 이벤트들을 진행함으로써 로보틱스 존에서 가장 많은 관심을 받음

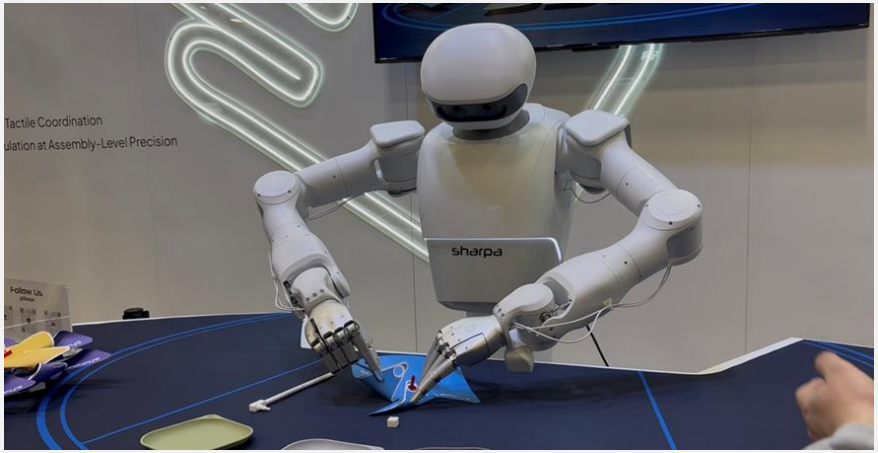
참가자와 복싱 경기를 진행하는 Unitree G1 모델

자료: UNITREE, 유진투자증권

SHARPA

- 인공지능 로봇 기업 샤르파는 금번 CES에서 자사의 첫 번째 Full-body 로봇인 노스(North)를 공개
- 노스는 생산성 향상에 초점을 맞추고 있으며, 목~허리, 어깨~손목에 이르기까지 사람과 유사한 상체 가동 범위를 구현
- North Hall에서 가장 큰 규모로 부스를 운영했으며, 탁구 경기, 종이접기, 사진찍기 등의 다양한 전시 및 체험존을 운영
- 특히 종이접기를 수행하는 로봇의 경우 진행 요원의 지속적인 방해에도 불구하고 정교하게 바람개비를 접는 훌륭한 퍼포먼스를 보임

종이 접기를 선보이는 SHARPA의 첫 번째 full-body 로봇 'North'



자료: Sharpa, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다 . 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. .따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	98%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	2%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2025.12.31 기준)